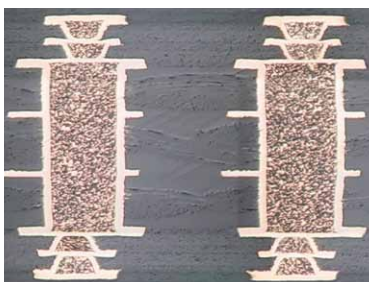


도금 Via 용 비도전성·도전성 홀 메움 Paste

DD Paste AE1125DS / AE1125HD / AE3030



2-4-2 Stack Via 형 Build Up 기판
홀 메움 Paste : AE1125HD

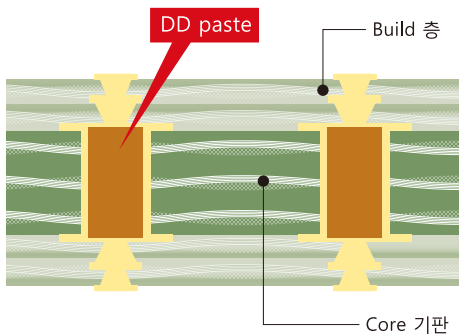


Via in Pad 기판 (Thermal Via)
홀 메움 Paste : AE3030

특징

- ▶ 열전도성 우수
- ▶ Voidless
- ▶ 평활성 우수
- ▶ 상부도금의 신뢰성 우수

구조



물성·성상

	Long Life Grade AE1125DS	범용 Grade AE1125HD	고열전도률 Grade AE3030
금속분	Cu분	Cu분	Ag Coat Cu 분
수지	에폭시수지	에폭시수지	에폭시수지
용제	무용제	무용제	무용제
점도 (BH형) (pa·s)	140	160	150
경화조건	가건조	80°C/30min	80°C/30min
	본경화	160°C/60min	160°C/60min
체적저항율 (Ω·cm)	10 ⁹⁻¹²	10 ⁹⁻¹²	2.0×10 ⁻⁴
Tg점 (DMA) (°C)	210	163	171
선팽창계수	α1 (ppm)	44	36
	α2 (ppm)	80	83
열전도율 (W/mk)	1.1	1.4	7.8
도금 Peel 강도	조화(粗化)있음(N/cm)	-	4.5
	조화(粗化)없음(N/cm)	7.1	7.8

가공 프로세스



장기신뢰성

항목	Long Life Grade AE1125DS		범용 Grade AE1125HD		고열전도률 Grade AE3030	
	상부도금 박리	들뜸량	상부도금 박리	들뜸량	상부도금 박리	들뜸량
Solder내열성 (288°C/10sec/3cycles)	없음	0	없음	0	없음	<5μm
열충격성 (-65°C/30min⇔ 125°C/30min/1000cycles)	없음	<4μm	없음	<4μm	없음	0
PCT (121°C/2atm/100%RH/336h)	없음	0	없음	0	없음	0